

证券代码：002185

证券简称：华天科技

天水华天科技股份有限公司  
华天科技 2024 年度业绩说明会  
投资者活动记录表

编号：2025-01

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活<br>动类别         | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他：<u>（请文字说明其他活动内容）</u></div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div></div> |
| 参与单位名称<br>及人员姓名       | 华天科技2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 时间                    | 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地点                    | 深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公司接待人员<br>姓名          | 主持人：华天科技<br>总经理：崔卫兵<br>副总经理、董事会秘书：常文瑛<br>财务总监：宋勇<br>独立董事：于燮康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活<br>动主要内容介<br>绍 | <p>1.公司先进封装市场份额如何？未来先进封装市场规模将如何发展？公司目前有哪些基地做先进封装，市场竞争力如何？</p> <p>答：公司子公司华天昆山、华天江苏、盘古半导体、华天南京以</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>及 UNISEM 主要开展先进封装业务。随着上述子公司建设投产以及规模的不断扩展，公司先进封装的市场规模将不断扩大，市场竞争能力将不断提高。谢谢！</p> <p><b>2.行业以后的发展前景怎样？</b></p> <p>答：展望 2025 年，随着人工智能大模型的发展，手机、电脑等消费市场回暖以及机器人领域的创新都将带动集成电路产品的销售。根据美国半导体行业协会预估，2025 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）也预测，2025 年半导体销售额将达到 6,972 亿美元。谢谢！</p> <p><b>3.您好，请问公司现在是否有 chiplet 相关业务订单，占比多少</b></p> <p>答：公司有 Chiplet 相关业务订单。谢谢！</p> <p><b>4.公司未来布局有哪些亮点？具体有哪些经营规划？业绩是否有新的增长点？</b></p> <p>答：公司未来持续进行技术创新和先进封装技术的研发工作，加强市场洞察和细分市场研究，重点开展面向 AI、XPU、存储器以及汽车电子相关应用或产品的开发，推进 2.5D 平台技术和 FOPLP 的成熟转化，积极布局 CPO 封装技术。上述新的发展领域将成为公司新的发展增长点。谢谢！</p> <p><b>5.崔总，您好，公司 2024 年业绩增长的主要因素有哪些？您如</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**何看 2025 年封测行业的发展趋势？需求端将如何发展？**

答：2024 年度，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。受此影响，公司订单增加，产能利用率提高，营业收入较去年同期有显著增长，从而使得公司经营业绩大幅提高。展望 2025 年，随着人工智能大模型的发展，手机、电脑等消费市场回暖以及机器人领域的创新都将带动集成电路产品的销售。根据美国半导体行业协会预估，2025 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）也预测，2025 年半导体销售额将达到 6,972 亿美元。谢谢！

**6.公司 2024 年发展有哪些亮点？各地先进封装基地建设进度如何？目前先进封装在公司产能中占比如何？**

答：2024 年度，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。受此影响，公司订单增加，产能利用率提高，营业收入较去年同期有显著增长，从而使得公司经营业绩大幅提高。2024 年度，公司子公司华天江苏、华天上海正式投产运行，盘古半导体已完成厂房和相关配套设施的建设，华天南京正式启动二期建设。随着各先进封装基地的投产和建设，公司先进封装占比将逐年提高。谢谢！

**7.公司之后的盈利有什么增长点？**

答：公司坚持发展封装测试主营业务，大力进行先进封装技术和

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>产品的研发及量产工作，推动先进封装成为公司未来盈利的增长点。谢谢！</p> <p><b>8.你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？</b></p> <p>答：公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 1 日披露，公司营业收入同比增长 28%，归母净利润同比增长 172.29%。截至目前，同行业部分公司年度报告还尚未披露，从已披露的同行业上市公司年报来看，大部分公司实现了营业收入和净利润的同比增长，但增长幅度各不相同。谢谢！</p> <p><b>9.请问 net margin 比 operating margin 高的原因是什么</b></p> <p>答：公司净利润比营业利润低。谢谢！</p> <p><b>10.公司本期盈利水平如何？</b></p> <p>答：关于公司 2025 年第一季度业绩情况请关注公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《2025 年第一季度报告》。谢谢！</p> <p><b>11.请问 net margin 比 operating margin 低的原因是什么</b></p> <p>答：公司净利润是在营业利润的基础上加减营业外收支，并计提所得税费用，因此净利润通常小于营业利润。谢谢！</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 日期   | 2025 年 4 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

